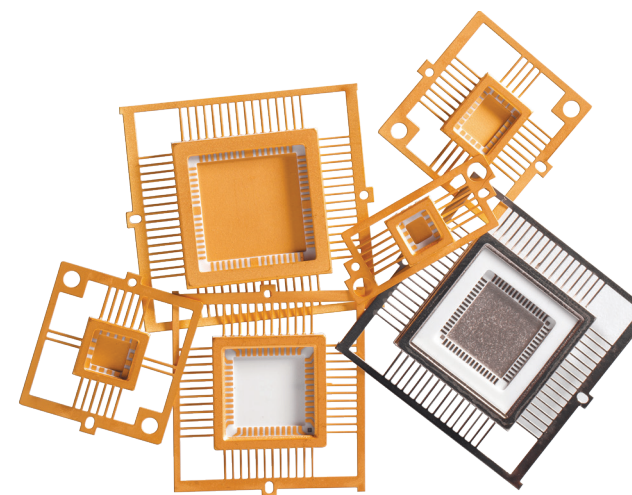
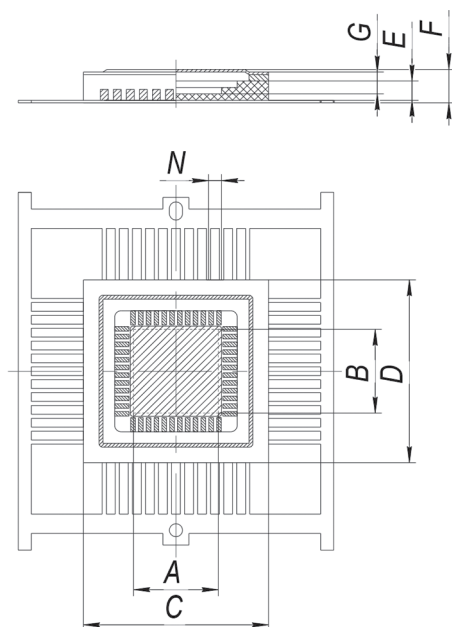




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

МП – монтажная площадка, КП – контактная площадка, Кр. – крышка, Число – номер вывода, МПР – место под радиатор, ТП – технологическая перемычка.

Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов, мм, N	Положение выводов по сторонам	Размер МП А*В, мм min	Расстояние между плоскостью МП и крышкой (под кристалл), мм min, G	Габаритные размеры платы С*Д*Е, мм min	Общая высота, F	Масса, не более, г	Монтажная площадка Металлизированная – «+», Неметаллизированная – «-»
5220.3-2.01К	3	1,5	2	1,8*1,6	0,71	4,6*4,25*0,7	1,7	0,2	радиатор
H02.8-1В	8+2ТП	1	2	2,5*2,3	1,3	6,5*6,5*1,5	2,9	0,42	-
H02.8-2В	8+2ТП	1	2	2,5*2,3	1,3	6,5*6,5*1,5	2,9	0,46	+
H02.14-1В	16	1	4	2,5*2,3	1,3	6,5*6,5*1,5	2,9	0,35	-
H02.16-1В	16	1	4	2,5*2,3	1,3	6,5*6,5*1,5	2,9	0,35	-
H04.16-1В	16	1	4	3,9*3,7	1,3	7,8*7,4*1,5	2,9	0,46	-
H23.16-1В	16	1	2	8,1*3,8	1,3	12,3*8,3*1,5	2,9	0,90	+

Метод герметизации	Максимальный ток, не более А	Резонансная частота, более, кГц	Внутреннее тепловое сопротивление (для максимального источника тепла), не более °С/Вт	Сопротивление изоляции не менее, Ом	Сопротивление токоведущих дорожек и соответствующих выводов, не более Ом	Электрически соединены
сварка	0,5		-	10 ¹⁰	0,2	3-МПР-Кр
сварка	0,5	7,5	30	10°	0,2	Кр-ТП2
сварка	0,5	7,5	30	10°	0,2	МП-ТП1; Кр-ТП2
сварка	0,5	7,5	30	10°	0,2	7-Кр; 15, 16 без связи с КП
сварка	0,8	7,5	30	10°	0,1	8-Кр
сварка	0,8	7,5	25	10°	0,1	8-Кр
сварка	0,7	7,5		10°	0,1	МП, Кр, выводы электрически изолированы

Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов, мм, N	Положение выводов по сторонам	Размер МП А*В, мм min	Расстояние между плоскостью МП и крышковой (под кристалл), мм min, G	Габаритные размеры платы С*Д*Е, мм min	Общая высота, F	Масса, не более, г	Монтажная площадка Металлизированная – «+», Неметаллизированная – «-»
H02.14-2B	16	1	4	2,5*2,3	1,3	6,5*6,5*1,5	2,9	0,38	+
H02.16-2B	16	1	4	2,5*2,3	1,3	6,5*6,5*1,5	2,9	0,38	+
H04.16-2B	16	1	4	3,9*3,7	1,3	7,8*7,4*1,5	2,9	0,52	+
5116.16-2	16	1	4	2,5*2,3	1,1	6,5*6,5*1,5	2,7	0,38	+
H02.14-3B	16	1	4	0,7*0,7	1,3	6,5*6,5*1,5	2,9	0,38	+
H04.16-3B	16	1	4	1,2*1,2	1,3	7,8*7,4*1,5	2,9	0,52	+
H09.18-1B	18	1	4	5,3*5,3	1,3	9,4*9,4*1,5	2,9	0,63	-
H09.18-2B	18	1	4	5,3*5,3	1,3	9,4*9,4*1,5	2,9	0,68	+
5206.20-1K	20	2,5	2	24,5*12,5	2,2	29*18,9*3	4,4	5,8	-
H06.24-1B	24	1	4	5,3*3,7	1,3	9,2*7,6*1,5	2,9	0,49	-
H08.24-1B	24	1	2	6,7*6,7	1,3	12*12*1,5	2,9	1,05	-
5122.24-1	24	1	4	5,3*3,7	1,1	9,2*7,6*1,5	2,7	0,54	+
H06.24-2B	24	1	4	5,3*3,7	1,3	9,2*7,6*1,5	2,9	0,54	+
H08.24-2B	24	1	2	6,7*6,7	1,3	12*12*1,5	2,9	1,15	+
5122. 24-2	24	1	4	5,8*4,5	1,3	9,2*7,6*1,5	2,9	0,54	-
H08.24-3B	24 +2ТП	1	2	7*7	1,3	13*12*1,5	2,9	1,55	-
H08.24-4B	24 +2ТП	1	2	7*7	1,3	13*12*1,5	2,9	1,57	+
H09.28-1B	28	1	4	5,3*5,3	1,3	9,4*9,4*1,5	2,9	0,69	+
5155.28-1K	28	2,5	4	22,8*12,5	2,3	29*18,9*3	4,4	5,7	+

Метод герметизации	Максимальный ток, не более А	Резонансная частота, более, кГц	Внутреннее тепловое сопротивление (для максимального источника тепла), не более °С/Вт	Сопротивление изоляции не менее, Ом	Сопротивление токоведущих дорожек и соответствующих выводов, не более Ом	Электрически соединены
сварка	0,5	7,5	30	10 ⁹	0,2	7-кp-МП; 15,16 без связи с КП
сварка	0,8	7,5	30	10 ⁹	0,1	8-МП-Кр
сварка	0,8	7,5	25	10 ⁹	0,1	8-МП-Кр
сварка	0,8	7,5	30	10 ⁹	0,1	8-МП-Кр
сварка	0,5	7,5	30	10 ⁹	0,2	7-кp, 4МП соединены соответственно с 3, 5,11,13
сварка	0,8	7,5	25	10 ⁹	0,1	8-Кр, 4МП соединены соответственно 3,6,11,14
сварка	0,6	7,5	15	10 ⁹	0,3	9-Кр
сварка	0,6	7,5	15	10 ⁹	0,3	9-МП-Кр
сварка	3		2	10 ⁹	0,15	7-Кр
сварка	0,9	7,5	18	10 ⁹	0,1	12-Кр
сварка	0,5	7,5	15	10 ⁹	0,2	6-Кр
сварка	0,9	7,5	18	10 ⁹	0,1	12-МП-Кр
сварка	0,9	7,5	18	10 ⁹	0,1	12-МП-Кр
сварка	0,5	7,5	15	10 ⁹	0,2	6-МП-Кр
сварка	0,5	7,5	18	10 ⁹	0,1	12-Кр
сварка	0,5	7,5	15	10 ⁹	0,2	Кр-ТП-2
сварка	0,5	7,5	15	10 ⁹	0,2	МП-ТП1; ТП2-Кр
сварка	0,6	7,5	15	10 ⁹	0,1	МП, Кр, выводы электрически изолированы
сварка	3		2	10 ⁹	0,15	7-МП-Кр

Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов, мм, N	Положение выводов по сторонам	Размер МП А*В, мм min	Расстояние между плоскостями МП и крышкой (под кристалл), мм min, G	Габаритные размеры платы С*Д*Е, мм min	Общая высота, F	Масса, не более, г	Монтажная площадка Металлизированная - «+», Неметаллизированная - «-»
H14.42-1B	42	1	4	6,7*6,7	1,3	12*12*1,5	2,9	1,05	-
H14.42-2B	42	1	4	6,7*6,7	1,3	12*12*1,5	2,9	1,07	+
H15.42-2B	42 +2ТП	1	4	6,7*6,7	1,3	12,5*12,5*1,5	2,9	1,30	-
H15.42-3B	42 +2ТП	1	4	6,7*6,7	1,3	12,5*12,5*1,5	2,9	1,38	+
5133.48-3	48	1	4	6,5*6,5	1,3	14,2*14,2*1,5	2,9	2,9	+
H16.48-1B	48	1	4	8,5*8,5	1,3	14,2*14,2*1,5	2,9	1,46	-
H16.48-2B	48	1	4	8,5*8,5	1,3	14,2*14,2*1,5	2,9	1,47	+
H18.64-1B	64	1	4	8,5*8,5	1,3	18,3*18,3*1,5	2,9	2,59	-
H18.64-2B	64	1	4	8,5*8,5	1,3	18,3*18,3*1,5	2,9	2,6	+
5134.64-3	64	1	4	5,4*5,4	1,3	18,3*18,3*1,5	2,9	2,6	+
5134.64-6	64	1	4	12*12	1,3	18,3*18,3*2,0	3,4	3,32	+
H18.64-3B	64 +2ТП	1	4	10*10	1,3	18,3*18,3*2	3,4	3,35	-
H18.64-4B	64 +2ТП	1	4	10*10	1,3	18,3*18,3*2	3,4	3,40	+

Метод герметизации	Максимальный ток, не более А	Резонансная частота, более, кГц	Внутреннее тепловое сопротивление (для максимального источника тепла), не более °С/Вт	Сопротивление изоляции не менее, Ом	Сопротивление токоведущих дорожек и соответствующих выводов, не более Ом	Электрически соединены
сварка	0,6	7,5	15	10°	0,2	21-Кр
сварка	0,6	7,5	15	10°	0,2	21-МП-Кр
сварка	0,6	7,5	15	10°	0,2	ТП1-Кр
сварка	0,6	7,5	15	10°	0,2	МП-ТП2; ТП1-Кр
сварка	0,8	5,6	33,5	10°	0,4	24-МП-Кр
сварка	0,8	7,5	15	10°	0,3	24-Кр
сварка	0,8	7,5	15	10°	0,3	24-МП-Кр
сварка	0,5	4,5	15	10°	0,3	32-Кр
сварка	0,5	7,5	15	10°	0,3	32-МП-Кр
сварка	0,5	7,5	15	10°	0,3	32-МП-Кр
сварка	1,5	4,5	15	10°	0,35	32-МП-Кр
сварка	0,5	7,5	15	10°	0,3	ТП2-Кр
сварка	0,5	7,5	15	10°	0,3	МП-ТП1; ТП2-Кр

